

证券代码：688126

证券简称：沪硅产业

公告编号：2026-019

上海硅产业集团股份有限公司

关于2025年年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货、预付款项和长期资产等进行全面充分的评估和分析，认为其中部分资产存在一定的减值迹象。经公司财务部门测算，公司2025年计提的各项减值损失总额约为68,970.82万元。具体情况如下表所示：

单位：人民币 万元

项目名称	本期计提(转回以“-”列示)金额
信用减值损失	
应收账款	-414.36
其他应收款	12.93
资产减值损失	
商誉	41,096.52
存货	26,142.94
固定资产	1,902.58
无形资产	230.21
合计	68,970.82

注：总数与各分项数值之和尾数不符的情形均为四舍五入原因所造成。

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1. 商誉减值准备

企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了进行减值测试，本公司分别对并购 Okmetic OY、上海新昇半导体科技有限公司、上海新傲科技股份有限公司所形成的包含商誉资产组进行商誉减值测试，根据可收回金额与包含商誉的

资产组或资产组组合账面价值比较，相应计提商誉减值准备。具体金额为：

单位：万元

资产组名称	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值	可收回金额	整体商誉减值准备	归属于母公司股东的商誉减值准备	本年度商誉减值损失
合并 Okmetic OY 所形成的包含商誉的相关资产组	164,827.32	129,873.84	-34,953.48	-34,953.48	13,100.73
合并上海新昇半导体科技有限公司所形成的包含商誉的相关资产组	211,052.69	236,600.00	-	-	-
合并上海新傲科技股份有限公司所形成的包含商誉的相关资产组	134,327.57	91,600.00	-42,727.57	-38,177.93	27,995.79

注：合并 Okmetic OY 所形成的包含商誉的相关资产组累计计提的商誉减值损失与商誉减值准备的差额为外币折算导致的差异。

2. 固定资产和无形资产减值准备

报告期内公司控股子公司新傲科技综合考虑其受托加工 200mmSOI 硅片业务的市场情况和客户的合作模式对 200mmSOI 硅片生产的相关资产组进行了资产减值测试，根据其预计可收回金额共需计提约 2,025.42 万元的减值损失，公司按照构成资产组的主要资产项目的账面价值分摊，需要计提 1,795.21 万元固定资产减值损失和 230.21 万元的无形资产减值损失。除此之外，公司对部分无法满足使用要求的设备设施进行了减值测试，根据这部分设备的预计可收回金额计提约 107.37 万元固定资产减值损失。

3. 存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司报告期内对存货项目进行减值测试，针对存货成本高于估计售价的硅片产品计提存货跌价损失约 26,142.94 万元。

4. 坏账准备

公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款和其他应收款的预期信用损失进行估计。经测试，2025 年公司需计

提的其他应收款项信用减值损失约为 12.93 万元，转回应收账款信用减值损失约 414.36 万元。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日